

에이직랜드, 'SEDEX 2024' 참가...첨단 ASIC 설계 서비스 기반 글로벌 비전 공개

- ▶ Edge AI 및 Automotive 솔루션 등 최신 개발 성과 공개로 시장 입지 강화
- ▶ 대만 R&D센터를 통한 선단 공정 기술 확보 및 글로벌 사업 확장 비전 공개

[2024-10-23] 에이직랜드가 SEDEX 2024(Semiconductor Exhibition 2024, 반도체대전)에 참가해 최첨단 반도체 기술과 최신 성과를 선보인다.

ASIC(주문형반도체) 디자인솔루션 대표기업 에이직랜드(445090, 대표이사 이종민)가 10월 23일부터 25일까지 사흘간 삼성동 코엑스(COEX)에서 개최되는 'SEDEX 2024'에 참가해 대만 R&D 센터를 통한 선단 기술 확보 및 글로벌 사업 비전 소개와 더불어 AI, Memory, Automotive 칩 관련한 최신 반도체 기술, 플랫폼을 선보인다고 23일 밝혔다.

SEDEX 2024는 한국반도체산업협회(KSIA)가 주관하며, 반도체 산업 생태계 전 분야가 참가하는 국내 최대 규모의 반도체 전문 전시회 중 하나로, 올해 26회를 맞이했다. 250개의 반도체 관련회사가 참여하며, 600개 이상의 부스가 운영된다. 에이직랜드는 국내 유일 TSMC VCA(Value Chain Alliance)이자, ARM ADP(Approved Design Partner)로 SEDEX 2024 참가를 통해 글로벌 반도체 리더들과의 전략적 제휴를 강화할 계획이다. 또한, Edge AI 및 Automotive 솔루션에서의 최신 개발 성과를 선보여 시장에서의 입지를 더욱 강화할 예정이다.

에이직랜드는 부스를 통해 ▲Aworld Magic ▲ALPS ▲TOAST 세 개의 플랫폼을 소개할 예정이다. Aworld Magic은 독자적인 SoC 설계 자동화 플랫폼으로, 에이직랜드만의 Spec-in 및 턴키(turn-key) 솔루션 노하우를 반영한 GUI 화면을 통해 통합적인 개발 환경을 제공한다. ALPS는 백엔드 설계 자동화 플랫폼으로, 세부적인 프로세스 리포트 제공으로 정확한 오류 수정과 효율적인 작업 관리를 가능하다. TOAST는 영상처리 장치를 기반으로 온디바이스 AI 환경에 최적화된 원스톱(One-Stop) 개발 솔루션으로, 아키텍처 구성부터 칩 테스트 및 양산까지 개발 전 과정을 지원해 Time-to-Market을 실현한다.

에이직랜드 이종민 대표이사는 "AI, Memory, Automotive 시장에서 반도체 수요가 증가함에 따라 저전력 고성능 칩 솔루션을 필요로 하는 시장이 생성되고 있다"며, "이번 SEDEX 2024 참가를 통해 에이직랜드의 기술력을 선보이고 전략적 제휴를 강화해 글로벌 시장 내에서의 ASIC 선도 기업으로써 입지를 강화해 나갈 것"이라고 전했다.

한편, 에이직랜드는 대만 신주시에 첨단 연구개발(R&D) 센터를 설립해 핵심 인재와 3nm·5nm 설계 기술, CoWos(Chip-on-Wafer-on-Substrate) 패키징 기술 확보에 박차를 가하고 있다.



[사진자료] 에이식랜드 SEDEX 2024 부스